



新闻发布

安靠科技推出业界首款封装设计套件 用以支持 Mentor 的高密度先进封装软件

安靠智慧封装™ 品牌加速了异构集成封装解决方案的准确设计和验证

美国亚利桑那州坦佩当地时间 2018 年 7 月 18 日，安靠科技（纳斯达克 AMKR），一家领先的半导体封装和测试外包服务提供商公布其与 Mentor 合作并发布了安靠智慧封装设计套件（PADK）。这是业界首款支持 Mentor 的高密度先进封装（HDAP）设计流程和软件。安靠科技屡获殊荣的高密度扇外型封装（HDFO）工艺现在可与 Mentor 软件结合使用，为物联网、汽车、高速通信、高速计算和人工智能应用所需的高级软件包提供及时、快速、准确的验证结果和人工智能应用。

安靠科技研发部副总裁 Ron Huemoeller 表示：“在专业封测代工厂中，安靠科技在 HDFO 技术方面处于领先地位。随着多芯片封装这种集成电路的复杂性增加，我们领先创建了基于 Mentor 软件的 PADK，可显著缩短设计周期。”他还表示：“因为 Mentor 的流程中包含 Calibre，一款被众多设计公司采用的验证签核软件，我们的客户可以轻松解决其整体设计中的物理验证问题。”

当今智能应用中愈加复杂且紧凑的电子器件设计，正在推动对尖端封装技术如异构集成和先进系统级封装的需求。这些解决方案将一个或多个不同功能的芯片以 2.5D（并排）或 3D 的结构，将更多更密的 I/O 接口相结合。借助安靠智慧封装 PADK 和 Mentor 经过验证的 HDAP 软件流程，安靠科技和 Mentor 的共同客户能够用安靠科技的 HDFO 工艺来创建和审查多个物件和 LVS（布局图与原理图）、连接、几何和零件间距方案。在这种图形环境下，芯片和基板的连接关系更加显著，在物理设计实施之前和实施过程中使用起来都非常直观，从而实现更快的验证签核和更少的验证周期。

Mentor BSD 副总裁兼总经理 AJ Incorvaia 表示：“安靠科技是第一家加入 Mentor OSAT 联盟计划的专业封测代工厂。同时，也是目前为止第一家为其客户建立和提供 PADK 的封测公司。”他还说：“通过 Mentor 成熟的 HDAP 软件流程和安靠充分验证 HDFO 工艺的 PADK，客户可以更轻松地从事传统芯片设计进阶到 2.5 和 3D 解决方案。”

OSAT 联盟计划有助于促进整个半导体产业链和设计链中 HDAP 的采纳、实施和发展，使半导体系统和设计公司能够为新兴封装技术提供一条康庄大道。

关于安靠科技：



新闻发布

安靠科技是全球最大的半导体封装和测试的外包服务供应商之一。安靠科技成立于 1968 年，作为一直致力于半导体集成电路封装和测试外包的先驱者，目前是 250 多家世界领先的半导体设计公司、晶圆厂和电子设备制造商的战略制造合作伙伴。安靠的运营基地占地面积 1000 万平方英尺，包括工厂、产品开发中心以及销售办公室，其位于亚洲、欧洲和美国主要电子制造区域。更多信息请关注网站：

www.amkor.com。

关于 **Mentor**：

Siemens 业务部门 **Mentor** 是电子硬件和软件设计解决方案的世界领导者，为世界上大多数成功的电子、半导体和系统公司提供产品、咨询服务和屡获殊荣的技术支持。

更多信息请关注网站：<http://www.mentor.com>。

###